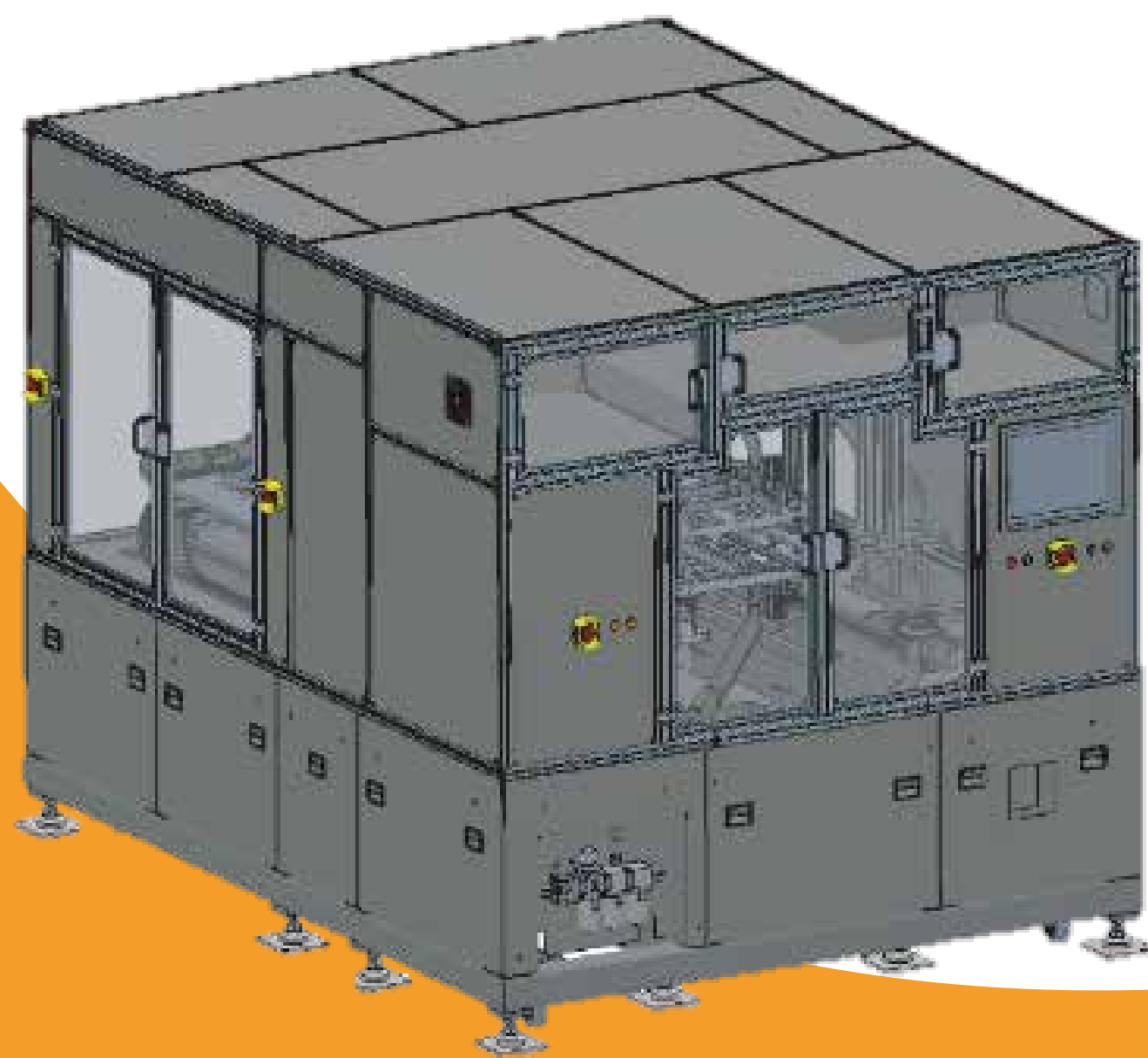


半導体パッケージ多面付けフルパネル基板検査装置 Full-panel Multi-unit Semiconductor Package inspection system

多機能化するパッケージ製品に求められる
ユニットサイズ大型化、多ピン化の製品検査に最適

Ideal for testing increasingly multifunctional packages,
featuring larger unit sizes and higher pin counts.



■ GATS-8370本体(検査部)
GATS-8370 main unit (inspection unit)



■ EFEM構成イメージ
Configured with EFEM image



■ L/UL構成イメージ
Configured with L/UL image

対応基板サイズ: 500mm x 620mm
最大治具ヘッドサイズ: 300mm

Compatible PCB Size: 500mm x 620mm
Maximum fixture head size: 300mm

検査ポイント: 上下総合48Kポイント
Inspection Points: 48K Points Top/Bottom

総合位置決め精度: $\pm 2.5\mu\text{m}$
Alignment accuracy : $\pm 2.5\mu\text{m}$

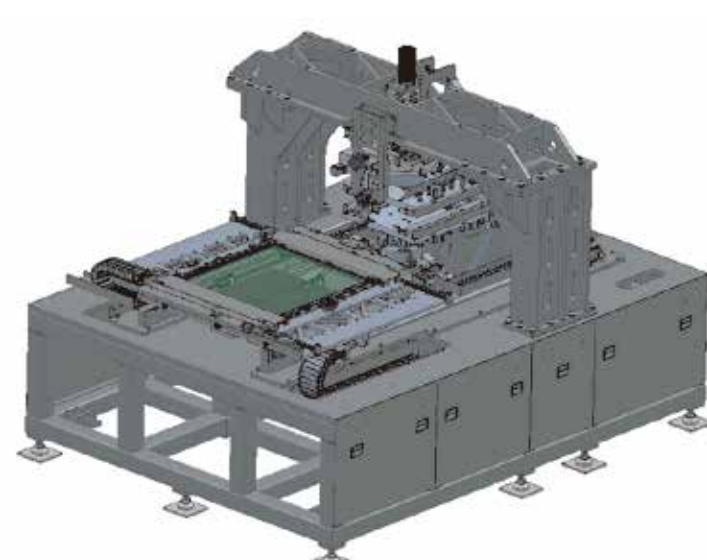
フルパネルサイズをハンドリング可能な
EFEM、L/ULと接続する提案も可能

Available with EFEM and L/UL integration, capable of handling full panel sizes

フルパネルサイズのハンドリング、大型ユニット製品の 一括検査に対応しつつ、高精度・高品質な検査をご提案

We offer high-precision, high-quality inspection solutions
for full-panel sizes and large unit products.

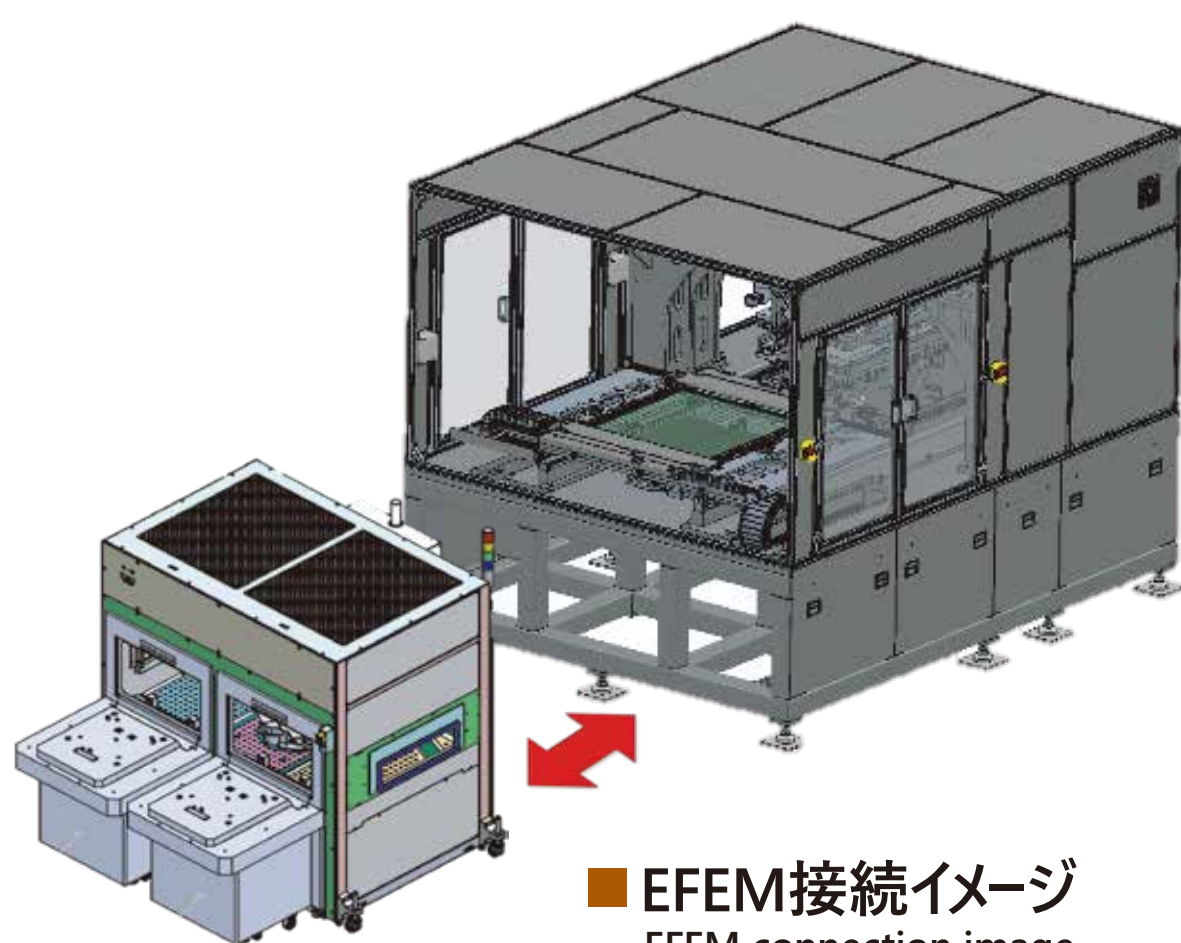
検査部イメージ Testing Unit Image



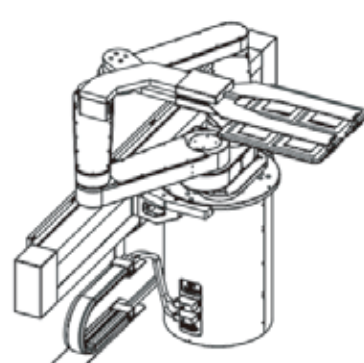
ユニット複数面付け@フルパネルの検査を1シャトル、
ステップ&リピートで実現。ユニットサイズとしては
Max□300mmまで対応可能。
総合アライメント精度 $\pm 2.5\mu\text{m}$ で
多ピン、狭ピッチ製品のコンタクト精度も確保。

Inspecting multiple panels on a full panel is achieved
in a single shuttle using a step-and-repeat process.
It accommodates unit sizes up to Max.
□300mm and ensures excellent contact accuracy for
multi-pin, fine-pitch products with an overall
positioning accuracy of $\pm 2.5\mu\text{m}$.

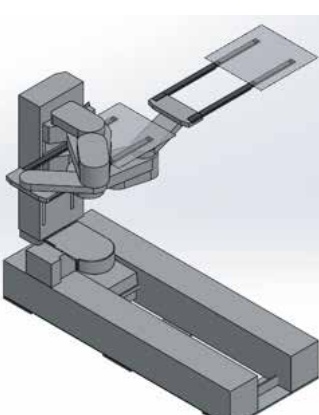
投入／排出機構イメージ Loading/Unloading Stacker Image



■ EFEM接続イメージ
EFEM connection image



■ EFEM内ロボット
Robots inside EFEM



主要スペック Key Specification

最大検査ポイント Maximum Test point	Total: 49,152p Top: 24,576p Bottom: 24,576p
ワークサイズ Work Size	500mm × 620mm
ワーク厚み Thickness	1.0mm～6.0mm
KOZ (MIN)	各辺10mm 10mm on each side
総合アライメント精度 Alignment accuracy	$\pm 2.5\mu\text{m}$
ワークホルダ Work Holder	手前/奥側サイドクランプ式 Front/Rear Side-Clamping Type
装置サイズ Equipment size	(W)2,000 × (D)2,600 × (H)2,000mm (Without EFEM or L/UL)